单晶硅太阳能电池硅与电极间的欧姆接触

谭富彬 赵 玲 陈亮维 蔡云卓 黄富春 李 茜 (昆明贵金属研究所,中国昆明 650221)

Ohmic Contact between Monocrystalline Silicon and Electrode in Solar Cell

Tan Fubin, Zhao Ling, Chen Liangwei, Cai Yunzhuo, Huang Fuchun, Li Qian (Kunming Institute of Precious Metals, Kunming 650221, China)

Abstract : The sintering process between monocrystalline silicon and silver paster or aluminium paster or silver - aluminium paster was observed and analyzed by metallography, X - ray diffraction and differential thermal analysis. The results show that alloys have formed between them, the Schottky Barries has eliminated and the Ohmic contact has established between silicon and electrode. **Key words :** Monocrystalline silicon ; Solar celi ; Silicon ; Electrode ; Ohmic contact

摘要:通过样品横断面金相观察,TG-DTA及X-射线衍射分析,证明单晶硅与银浆、 铝浆(银铝浆)在烧结过程中形成合金,消除硅与电极间的肖特基势垒,使电极与硅形成欧 姆接触。
关键词:单晶硅;太阳能电池;硅;电极;欧姆接触
中图分类号:TM615 文献标识码:A 文章编号:1004-0676(2001)01-0012-05

太阳能是取之不尽,无污染、无噪音的新能源。随工业发展及人类活动的增加,地下矿物能源 日趋短缺,开发、利用太阳能已是当务之急。太阳能电池是开发、利用太阳能的手段之一,它是直 接将太阳能变成电能的半导体器件,然后组装成不同电压、电流和功率的装置,从而使人们获得新 能源。电池可以用于空间技术、兵站、航标及其他缺电无电的边远地区。电池的电极引出线通过蒸 镀、化学镀、压结、印刷烧结的方法获得。不管那种方法,要消除电极与硅间的肖特基势垒,形成 欧姆接触。本文重点讨论用厚膜工艺印刷、烧结后与硅生成合金,使电极与硅形成欧姆接触^[1]。电 池栅极(受光面)是掺杂了其他元素的银电极,背场电极(背阳面)用铝电极及银铝电极。作者通过电 极与硅形成合金,从而使硅与电极间消除了肖特基势垒,实现欧姆接触。这样拓宽了厚膜浆料的应 用范围(即印刷在导电基片上),也提高了硅太阳能电池的生产效率^[2]。

1 实 验

7

1.1 银电极的制备:选用粒度 0.2µm 的银粉,掺杂少量过渡族或 、 族元素,按比例加入玻 璃粉,再用乙基纤维素松油醇配成厚膜浆料,丝网漏印在单晶硅片上,烘干、在700 左右烧结后 得硅太阳能电池受光面栅极,呈欧姆接触,用铅锡浆载流焊得引出线。

* 收稿日期: 1999-10-11 基金项目: 云南省科委应用基础研究资助项目(1993-06)

13

1.2 铝电极的制备:将粒度 10µm的铝粉,按比例加入玻璃粉,再加入乙基纤维素松油醇制成浆料。然后经印刷、烘干,650 左右烧结后得硅太阳能电池背场电极,呈欧姆接触。

1.3 银铝电极的制备:选择粒度 10µm的铝粉,按比例与粒度 0.2µm的银粉混合,加入玻璃粉,再用乙基纤维素松油醇混合得浆料。然后丝网漏印、烘干在硅片上,经650 左右烧结得背场银铝电极,呈欧姆接触,用铅锡浆载流焊得引出线。

1.4 金相样品的制备:将已烧结的 Ag - Si、AgAl - Si、Al - Si 片放在镶样粉中,加热压结成块,经 金相制样,然后用 MeF₂ 万能金相显微镜,在明场条件观察其界面。

1.5 TG-DTA 实验:将印刷烘干未烧结的 Ag-Si、AgAl-Si、Al-Si 电极,在 Thermofler TG-DTA 上进行升温测定,加热速度 10 K/min,热重灵敏度为 2mg 满刻度,差热灵敏度 ±50 µV 满刻度,图速 2.5mm/min,气氛为静态空气。3 种电极测试用量分别为 14.6mg、18.4mg、18.5mg,参比物 Al₂O₃ 粉,样品皿均为 Al₂O₃ 坩埚。

1.6 X-射线衍射实验:用日本理学公司的 D/max-RC型旋转阳极铜靶衍射仪进行分析,实验条件:管压 40kV,管流 80mA,DS、SS分别为 1°,RC为 0.3mm,用石墨单色器滤去 CuK 线,用软件进行 CuK₂剥离。Ag-Si、AgAl-Si、Al-Si 电极烧结后逐层抛磨,逐层 X-射线衍射,直至露出硅为止。

2 结果与讨论

2.1 银电极:银电极又称栅极或受光面电极^[2]。用网状图案的目的是提高受光面积,电极复盖面 允许占受光面积的 8 % ~ 10 %。Ag 电极是通过掺杂少量、 族或过渡族元素,烧结而成。在理论 上,掺杂元素与硅形成合金或金属间化合物,形成欧姆接触。作者进行了以上元素的掺杂试验,未 发现与硅形成的合金相或金属间化合物。图 1 是银浆烧结在单晶硅片上的 X-射线衍射的结果。图 1 a 是低浓度掺杂,图1b是高浓度掺杂,不同浓度的元素M都未发现与硅形成合金或金属间化



图 1 银电极的 X-射线衍射图

Fig. 1 The X - ray diffraction pattern of the silver electrode

 $(a Ag_aM, b Ag_bM)$

合物。金相观察只发现银与硅的界面有锯形花样出现。企图通过 X - 射线衍射分析硅与掺杂元素 M 形成合金或金属间化合物是很困难的。通过计算单晶硅及烧结银浆后硅的点阵参数变化,判断单晶 硅烧结前后的界面状态。计算依据,单晶硅属立方晶系,晶面间距 d_{hkl}与晶面指数(hkl)的关系: 所以: $a = \sqrt{h^2 + k^2 + L^2} d_{hkl}$

因为: $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{b^2 + k^2 + L^2}}$ 对于(400) 晶面, h=4, k=L=0, a=4 d_{hkl}, d 为实验值, 计算结果列于表 1 中。 8 Si

不同掺杂元素量的银电极金相(300 x) 图 2

The metallograpy of the silver electrode containing the different added elements Fig. 2

(a Ag_aM, b Ag_bM)

表1 不同掺杂浓度的单晶硅点阵参数

Tab. 1 The structure parameters of the monocrystalline silicon with the different content of added elements

样 品	晶面(hkl)	晶面间距(nm)	点阵参数(nm)
Aga 与单晶硅	(400)	0.135 7	0.542 8
Ag_b 与单晶硅	(400)	0.135 6	0.542 4
单晶硅	(400)	0.135 5	0.542 0

从表中结果知道,单晶硅与 Aga、Agb 比较,单晶硅点阵参数小些,这是掺杂引起的。点阵参 数的微小变化,消除了银与硅之间的界面势垒,形成了欧姆接触。在文献[2]中,掺钛时出现敏锐 的衍射峰。掺杂元素 M 可以是 P、As、Sb、Bi、Ni、Sn、Ti、Ge、Pb、Zn、Cd、Ag、Au、Hg、Pd 等,选择范围很广。通过差热分析发现(图 3)在294 有机物燃烧放热。在 480 处有吸热峰,比生 产线低约 50 ,吸热峰温度与掺杂元素 M 有关,作者认为是合金或金属间化合物形成吸热。TG-DTA 的特征温度与元素 M 有关,在工艺上往往是多种元素按不同比例混合而成。



2.2 铝电极:单晶硅太阳能电池背场印烧了铝电极^[3]。铝与硅容易形成合金,图4是铝电极的 TG - DTA 分析结果,在 621 有吸热峰,比生产上实际烧结温度低 30 。通过 X - 射线衍射分析(图

5)、发现 Alagy Sin an 的铝硅合金,这样消除了硅铝界面的肖特基势垒,使硅铝间呈欧姆接触。

 $\begin{array}{c} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\$

图 5 铝电极的 X - 射线 衍射图 Fig. 5 The X - ray

diffraction spectroscopy of Al electrode

(1 Al 3.21, Si 0.47, 2 Al, 3 Si)

2.3 银铝电极:由于铝电极不能铅锡浆载流焊,因而在背¹⁰⁰场同时印烧了银铝电极,除了要求硅铝间呈欧姆接触外,必须铝锡浆载流焊^[4]。有些工艺不用铝电极,仅用银铝电极,为了降低成本,电极设计成网状。用TG-DTA分析发现(图⁸⁰6),在316 有放热峰,铝电极无此现象,可以认为是 AgAI合金的生成热。在542 有吸热现象,比铝电极低约 80,5银存在有关。可以理解人们采用比铝电极高出数倍价格的⁶⁰银铝电极了。图7是银铝电极的 X-射线衍射结果。证明经烧结后生成了 Ag2AI、Al3.21Si0.47及 AlSi 等。图 8 是银铝电极的金相照片,在界面有硅、黑色层及 AgAI合金存在。在硅⁴⁰与银铝之间的黑色层正是作者所希望的,X-射线衍射证明它们是 AlSi、Al3.21Si0.47合金,使硅与电极呈欧姆接触。3种电极由于有机物燃烧失重。²⁰

2.4 电池性能:印烧了银浆、铝浆(或银铝浆)的单晶硅, 它就是已具有光伏特性的太阳能电池,当受光面(银电极) 受阳光照射,光能转换为电能时,电池即有电流、电压输 出^[5]。作者用晶体管特性仪定性测定 I-V 特性,结果见图 9。如果 OA 与y(I)轴平行,电极与硅呈最佳欧姆接触,串联

电阻为最小值;当 OA 与y(I) 轴成夹角,欧姆接触不良,串联电阻偏大,电池光电转换效率偏小。 串联电阻与电极浆料密切相关。当 OB 与x(v) 轴平行,并联电阻达最大值;当 OB 与x(v) 轴成夹角, 并联电阻偏小,电池在使用过程中 P-N 结易击穿。并联电阻除与硅杂质扩散、切削、等离子腐蚀 等有关外,与电极浆料也有关^[5]。串联电阻、并联电阻为最佳值时,电池短路电流 >2 600mA、开 路电压 > 610mV、并联电阻 > 15 Ω、串联电阻 < 0.020 Ω、填充因子 > 75 %,光电转换效率 > 15 %。

3 结 论

4. 5k

1

2

1

2

通过样品横断面金相观察,TG-DTA及X-射线衍射分析,包括计算样品的点阵参数,证明单 晶硅与银浆、铝浆(银铝浆)在烧结过程中形成合金,消除硅与电极间的肖特基势垒,使电极与硅形 成欧姆接触。

刘雄教授、赵万春同志提供 TG- DTA 分析数据,特此表示致谢!



银铝电极的 DTA 曲线

electrode

The DTA curve of Ag - Al

图 6

Fig. 6



参考文献

2

- [1] 陈克铭等. 金属 n型 GaAs 界面物理特性研究 [J]. 半导体学报, 1982, 3 (10: 31~43.
- [2] 赵 玲,谭富彬等.太阳能电池用银导体浆料的研究 [J].电子元件与材料,1996,15 (3):13~16.
- [3] 谭富彬,赵 玲,刘 林等. 具有欧姆接触特性 PTC 热敏电阻用电极浆料 [C]. 贵金属 (增刊), 1997. 455~458.
- (4) SV1415324, SU1415233
- [5] 汪义川,陈庭金.太阳能电池电极工艺对其并联电阻和影响 [J]. 云南师范大学学报,1991,15 (10):44~48.